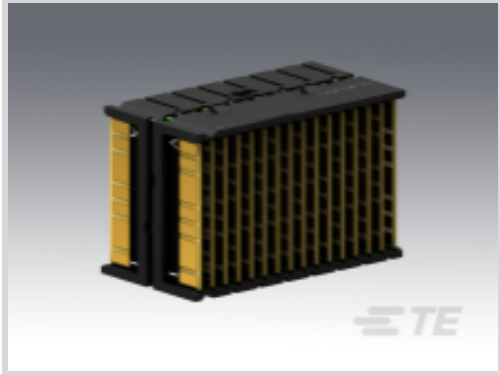




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速连接器



连接器系统: 板对板

Number of Positions: 112

Row-to-Row Spacing: 1.8 mm [.071 in]

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化, 极化

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
护罩种类	不带罩
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	112
行数	7
列数	16
背板架构	传统背板
PCB 安装方向	垂直
引导位置	无引导

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1 A
-------------	-----

机械附件

接合对准	带有
接合对准类型	极化, 极化
连接器安装类型	板安装



壳体特性

有带罩的边数	0
--------	---

尺寸

Row-to-Row Spacing	1.8 mm[.071 in]
--------------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2000676-1
Keyed Guide Pin, Machined, Vita 46



TE 产品编号 2000713-1
RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined



TE 产品编号 2302317-1
RA ASSY, 7 Row, Cent DP, MULTIGIG RT 2-S

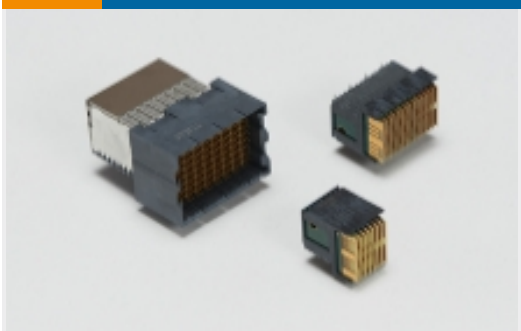


TE 产品编号 2302785-1
RA PLUG ASSY, 7ROW, CENTER, VPX, MG RT3

该系列中的其他产品 | MULTIGIG RT 2-R

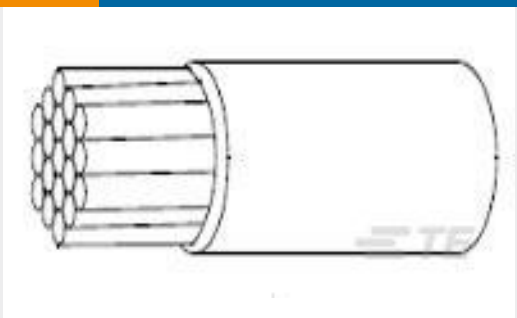


背板引导硬件(11)



高速背板连接器(21)

客户还购买了



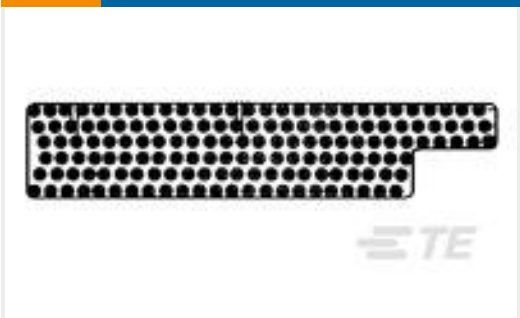
TE 产品编号4774693001
55/9960-22-9(LAT3)



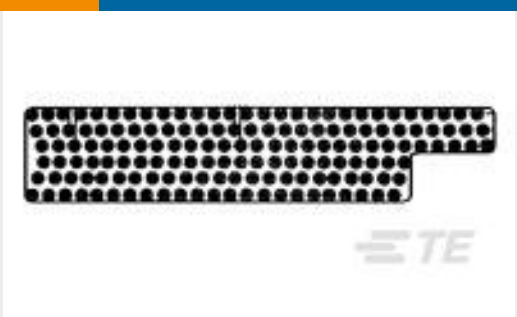
TE 产品编号5767130-4
MICT, RCPT, 152, ASY, GOLD, EXT D



TE 产品编号749202-2
50 50SR KIT, 75D, UK



TE 产品编号445274-1
HDI INTERFACIAL SEAL-RT HALF



TE 产品编号445525-1
HDI INTERFACIAL SEAL-LT HALF



TE 产品编号EG2925-000
55A4122-16-2/9-9

文档

产品图纸

Mezzanine Conn, 25mm stack height, 16

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2226027-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2226027-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2226027-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Board-Level Interconnects for Rugged Embedded Computing Brochure](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本